

性能特点：

- 频带：DC~18GHz
- 插入损耗：1.7dB
- 隔离度：40dB
- 输入/输出回波损耗：17dB /17dB
- 控制电压：0/-5V
- 芯片尺寸：1.38mm×1.4mm×0.1mm

产品简介：

HH-SW30018 是一款 GaAs MMIC 反射式单刀三掷开关芯片，其频率范围覆盖 DC~18GHz，整个带内插损小于 1.7dB，隔离度大于 40dB。HH-SW30018 采用 0/-5V 供电。

电参数： (T_A=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	DC~18			GHz
插入损耗	-	-	1.7	dB
隔离度	40	-	-	dB
输入回波损耗	17	-	-	dB
输出回波损耗	17	-	-	dB

使用限制参数： (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

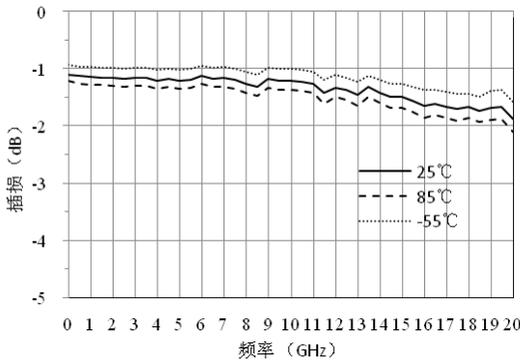
输入功率	+30dBm
控制电压	-8~+1V
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

开关真值表：

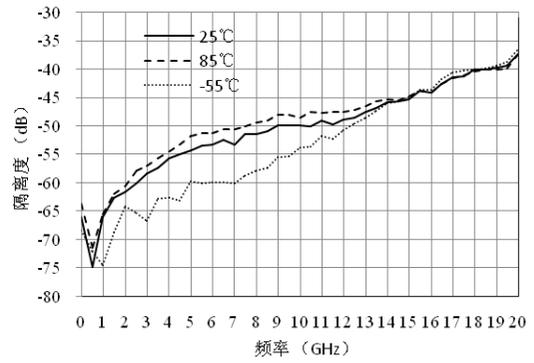
V1	V2	V3	V4	V5	V6	IN-OUT1	IN-OUT2	IN-OUT3
0	-5	-5	-5	0	0	ON	OFF	OFF
-5	0	0	-5	-5	0	OFF	ON	OFF
-5	-5	0	0	0	-5	OFF	OFF	ON

典型曲线：

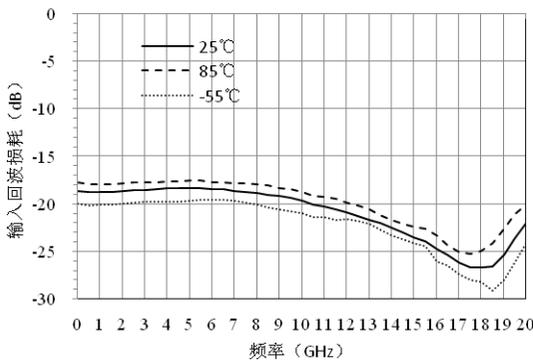
插损 Vs 温度



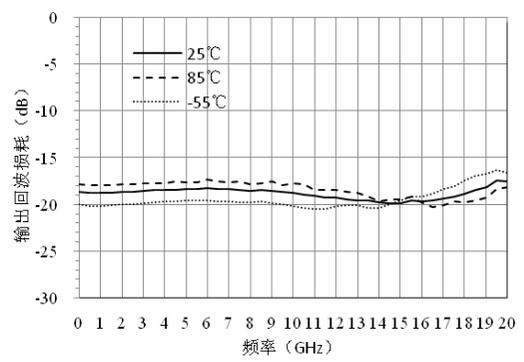
隔离度 Vs 温度



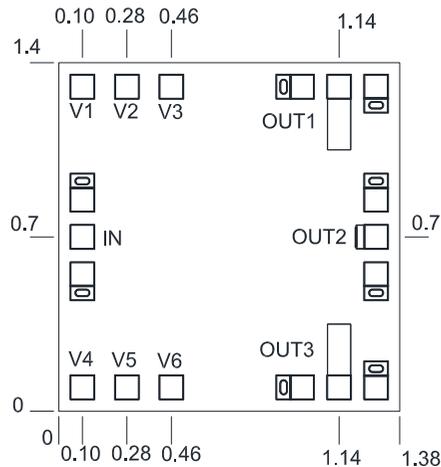
输入回波损耗 Vs 温度



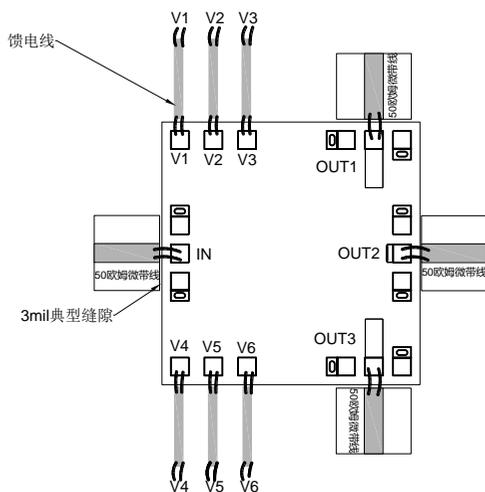
输出回波损耗 Vs 温度



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

注意事项：输入输出无隔直电容

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。